

114學年度進修部 電子工程系-封裝測試產業精英專班 二技課程規劃表

第一學年(114)						第二學年(115)					
	科目	上學期		下學期			科目	上學期		下學期	
		學分	時數	學分	時數			學分	時數	學分	時數
校必修											
	小計	0	0	0	0		小計	0	0	0	0
院必修						院必修					
	小計	0	0	0	0		小計	0	0	0	0
專業必修	※測試能力鑑定(一)	3	3			專業必修	※封裝能力鑑定(一)	3	3		
	※BIB治具設備操作與維修概論	3	3				※Tester設備操作與維修概論	3	3		
	※Laser Marker設備操作與維修概論	3	3				※Handler設備操作與維修概論	3	3		
	※Lead Scanner原理與應用	3	3				※HF設備操作與維修概論	3	3		
	※半導體製程實務	3	3				※積體電路工程	3	3		
	※實務專題	3	3				※半導體元件	3	3		
	※半導體產業分析			3	3		※半導體製程技術			3	3
	※捲帶機原理與應用			3	3		※積體電路可靠性工程			3	3
	※打線機原理與應用			3	3		※Oven設備操作與維修概論			3	3
	※黏晶機設備操作與維修概論			3	3		※LD/UL設備操作與維修概論			3	3
	※測試能力鑑定(二)			3	3		※治具設備操作與維修概論			3	3
	※實務專題			3	3		※封裝能力鑑定(二)			3	3
	小計	18	18	18	18		小計	18	18	18	18
專業選修						專業選修					

【科目類別】		學分	時數
通識科目、共同科目	校必修	0	0
	院必修	0	0
專業科目	專業必修	72	72
	專業選修	0	0
合計		72	72

注意事項：

- 畢業應修學分為72學分；含必修：__72__學分，選修：__0__學分（本系專業選修至少__0__學分以上，其餘可跨系）
- 表列選修課程僅供參考，依實際狀況調整。

114.2.20

明新科技大學電子系
課程教學小組

電子工程系 張承勛
主 任

半導體學院 張 合
院 長

